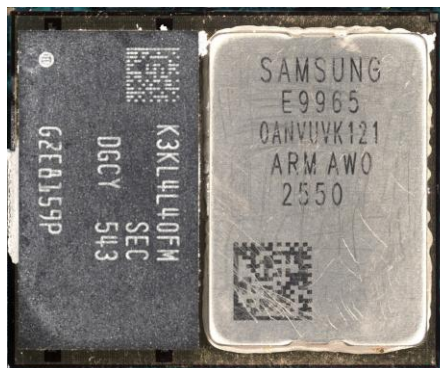


SoC: Samsung Exynos 2600平面解析レポート



Exynos2600 PKG Top view



Exynos2600 PKG Bottom view

レポート概要

Samsungは、次世代SoC「Exynos 2600」を開発し、同社のフラッグシップモデルであるGalaxy S26シリーズに搭載しています。

本SoCのパッケージング技術では、熱管理性能を向上させるため、APチップ直上に熱伝達構造(HPB: Heat Path Block)を配置し、その隣接領域にDRAMを配置した構造を採用しています。

この構造により、APチップの片側にDRAM接続用Cuピラー群を配置する非対称レイアウトが形成され、RDL(再配線層)においても信号線および電源ラインの引き回しが通常とは異なる特異なパターンを持ちます。

本解析では、DRAM側に配置されたCuピラー群およびRDLの配線レイアウトを詳細に観察し、各領域における信号・電源配線の取り回しを追跡することで、HPBとDRAMが並列配置されたパッケージにおける特有のインターコネクト構造を明らかにしました。

製品特徴

- ・ HPB配置によりDRAM側に配置されたCuピラー群
- ・ RDLの信号線および電源ラインの特異な引き回しパターン

解析内容・レポート価格

- ・ 製品分解
- ・ 各層レイアウト写真
- ・ ODB++、Gerber、Viewerデータ化

価格：2,850,000円(税別)

発注後1weekで納品

Table of contents

	Page
1. Galaxy S26+ overview	. . . 3
2. Galaxy S26+ Teardown	. . . 4
3. Overview of PCB	. . . 6
4. X-ray of PCB	. . . 10
5. Overview of Exynos 2600	. . . 12
6. Removal of each layer of lower PKG	. . . 14
7. Removal of each layer of upper PKG	. . . 19
8. Parts position of Exynos 2600	. . . 21
9. Element Measurement	. . . 22



Lower RDL L1 layer



Upper RDL L1 layer